

(19) 日本国特許庁(JP)

## 再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

WO2004/091255

発行日 平成18年7月6日 (2006.7.6)

(43) 国際公開日 平成16年10月21日 (2004.10.21)

(51) Int.CI.	F 1	テーマコード (参考)
<b>A61B 8/00</b> (2006.01)	A61B 8/00	2 G 04 7
<b>G01N 29/24</b> (2006.01)	G01N 29/24	4 C 6 0 1
<b>HO4R 17/00</b> (2006.01)	HO4R 17/00	5 D 0 1 9
<b>HO4R 31/00</b> (2006.01)	HO4R 17/00	3 3 2 Y
	HO4R 31/00	3 3 0

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 19 頁)

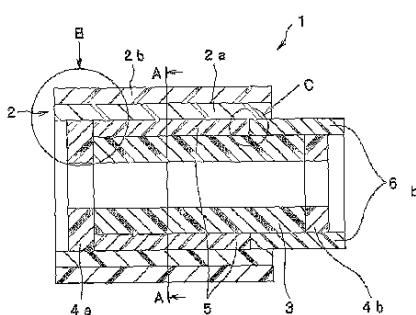
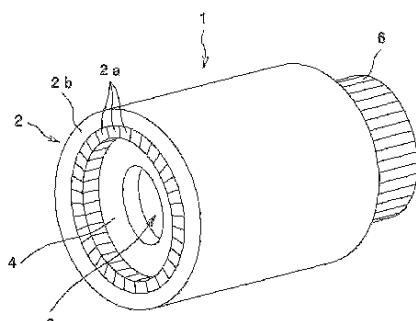
出願番号	特願2005-505243 (P2005-505243)	(71) 出願人	000000376 オリンパス株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
(21)国際出願番号	PCT/JP2004/004777	(74) 代理人	100076233 弁理士 伊藤 進
(22)国際出願日	平成16年4月1日 (2004.4.1)	(72) 発明者	沢田 之彦 東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目43番2号オリ ンパス株式会社内
(31)優先権主張番号	特願2003-98216 (P2003-98216)	F ターム (参考)	2G047 AA12 AC13 CA01 DB02 EA11 EA16 GB02 GB18 GB21 GB29 GB32 GB35 4C601 BB06 BB24 EE10 EE14 GB05 GB41 GB44 5D019 BB02 BB20 FF04 GG01 HH03
(32)優先日	平成15年4月1日 (2003.4.1)		
(33)優先権主張国	日本国 (JP)		
(31)優先権主張番号	特願2003-98217 (P2003-98217)		
(32)優先日	平成15年4月1日 (2003.4.1)		
(33)優先権主張国	日本国 (JP)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】超音波振動子及びその製造方法

## (57) 【要約】

超音波振動子は、少なくとも硬質な材料で形成された層を含む音響整合層と、音響整合層を構成する硬質な材料で形成された層の所定位置に音響整合層の一部が突出する位置関係に固定配置される両平面部に電極をそれぞれ設けた圧電体と、硬質な材料で形成された層の面に固定配置される少なくとも一面側に導電パターンを形成した基板と備え、この配置状態で圧電体及び基板を複数の圧電素子及び所定の導電パターンを配置した基板に分割して複数の圧電素子を配列させた超音波振動子であって、基板の導電パターンと、この導電パターンと電気的に接続される圧電体の電極の少なくとも一部とを同一方向に向か、この基板を圧電体に隣接配置し、分割される基板上の導電パターンと圧電体の電極とをそれぞれ導電部材を介して電気的に接続している。



**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

少なくとも硬質な材料で形成された層を含む音響整合層と、前記音響整合層を構成する硬質な材料で形成された層の所定位置に前記音響整合層の一部が突出する位置関係に固定配置される両平面部に電極をそれぞれ設けた圧電体と、前記硬質な材料で形成された層の面に固定配置される少なくとも一面側に導電パターンを形成した基板と備え、この配置状態で前記圧電体及び基板を複数の圧電素子及び所定の導電パターンを配置した基板に分割して複数の圧電素子を配列させた超音波振動子において、

前記基板の導電パターンと、この導電パターンと電気的に接続される圧電体の電極の少なくとも一部とを同一方向に向け、この基板を前記圧電体に隣接配置し、分割される前記基板上の導電パターンと前記圧電体の電極とをそれぞれ導電部材を介して電気的に接続することを特徴とする超音波振動子。10

**【請求項 2】**

前記導電部材は、金属ロウ、超音波接合、接着剤で接続固定される導電性部材、導電性接着剤、導電塗料、焼付け、スパッタ、イオンプレーティング、CVD又は蒸着の中のいずれか及びこれらの組合せによって設けられる導電性の膜部材であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の超音波振動子。

**【請求項 3】**

前記膜部材は厚膜であることを特徴とする請求の範囲第1項または請求の範囲第2項に記載の超音波振動子。20

**【請求項 4】**

前記膜部材は薄膜であることを特徴とする請求の範囲第1項または請求の範囲第2項に記載の超音波振動子。

**【請求項 5】**

少なくとも硬質な材料で形成された音響整合層に設けられるグランド電極と、

前記硬質な材料から音響整合層に電極を有する所定形状の圧電体を固定して形成される第1積層体と、

前記硬質な材料で形成された音響整合層面に、所定間隔で形成した複数の導電パターンを有する所定形状の基板を、前記圧電体に隣接固定して形成される第2積層体と、

前記圧電体の電極と前記基板の導電パターンとを一体で電気的に接続される導電部材と30

、  
前記導電部材を設けて電気的に接続された圧電体及び基板に形成される所定間隔及び所定深さ寸法の分割溝と、

を具備することを特徴とする超音波振動子。

**【請求項 6】**

前記圧電体の厚み寸法及び前記基板の厚み寸法を略同一に設定したことを特徴とする請求の範囲第5項に記載の超音波振動子。

**【請求項 7】**

前記導電部材は膜部材であることを特徴とする請求の範囲第5項または請求の範囲第6項に記載の超音波振動子。40

**【請求項 8】**

前記膜部材は厚膜である請求の範囲第5項ないし請求の範囲第7項のいずれかに記載の超音波振動子。

**【請求項 9】**

前記膜部材は薄膜である請求の範囲第5項ないし請求の範囲第7項のいずれかに記載の超音波振動子。

**【請求項 10】**

少なくとも硬質な材料で形成された音響整合層にグランド電極を設ける工程と、

前記硬質な材料から音響整合層に電極を有する所定形状の圧電体を固定して第1積層体を形成する工程と、50

前記硬質な材料で形成された音響整合層面に、所定間隔で形成した複数の導電パターンを有する所定形状の基板を、前記圧電体に隣設固定して第2積層体を形成する工程と、

前記圧電体の電極と前記基板の導電パターンとを一体で電気的に接続する導電部材を設ける工程と、

前記導電部材を設けて電気的に接続された圧電体及び基板に所定間隔及び所定深さ寸法の分割溝を形成する工程と、

を具備することを特徴とする超音波振動子の製造方法。

#### 【請求項 1 1】

前記圧電体の厚み寸法及び前記基板の厚み寸法を略同一に設定したことを特徴とする請求の範囲第10項に記載の超音波振動子の製造方法。 10

#### 【請求項 1 2】

前記導電部材は膜部材であることを特徴とする請求の範囲第5項または請求の範囲第11項に記載の超音波振動子の製造方法。

#### 【請求項 1 3】

前記膜部材は厚膜である請求の範囲第10項ないし請求の範囲第12項のいずれかに記載の超音波振動子の製造方法。

#### 【請求項 1 4】

前記膜部材は薄膜である請求の範囲第10項ないし請求の範囲第12項のいずれかに記載の超音波振動子の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】 20

##### 【技術分野】

本発明は超音波診断装置等に用いられる超音波振動子に関する。

##### 【背景技術】

医療分野においては、超音波振動子から生体組織に向けて超音波を送信すると共に生体組織から反射される反射波を、超音波を送信した超音波振動子と同一あるいは別体に設けた超音波振動子で受信して信号処理を行って画像化することにより生体組織の情報を得る超音波診断装置が従来より種々提案されている。

このような超音波診断装置などに用いられる超音波振動子として、複数の圧電素子を規則的に配列した電子走査方式の超音波振動子がある。この超音波振動子には数多くの圧電素子が整列配置されており、それぞれの圧電素子には超音波観測装置から延出する信号線が電気的に接続されている。そして、前記圧電素子と前記信号線との電気的な接続は、配線基板或いはリード線によって行われている。 30

例えば、特公平4-19858号公報のアレイ型超音波探触子では圧電振動子の配列間に略等しい間隔にて複数の基板電極を整列してプリントされているフレキシブル基板によって、このフレキシブル基板の基板電極とそれぞれの圧電振動子とを接着によって電気的に接続している。

また、特許2502685号公報の超音波探触子の製造方法ではフレキシブルの電気端子と曲面体上フレキシブル基板とを金線等のワイヤを用いて、ワイヤボンディング等によって各チャンネル毎に1対1で接続していた。 40

さらに、特許3248924号公報には、圧電材料とフレキシブルプリント回路基板とを平行もしくは平行に近い状態に保ちながら信号電極とリード線を電気的に接続し切り込んで各圧電素子を形成することによって、超音波送受波特性の良い超音波探触子の製造方法が示されている。

しかしながら、前記特公平4-19858号公報のアレイ型超音波探触子では、フレキシブル基板の各電極と圧電振動子の各電極との位置合わせを行った後、接着固定して電気的接続を行っているが、この作業は熟練を要する作業の一つで、コストアップの要因になっていた。

また、前記特公平4-19858号公報のアレイ型超音波探触子及び特許3248924号公報の超音波探触子の製造方法では、フレキシブル基板を曲げ状態にすることによってこのフレキシブル基板の弾性力が残留応力となることによって不具合が生じるおそれがあ 50

ある。

さらに、前記特許 2502685 号公報の超音波探触子の製造方法では、ワイヤを用いて、ワイヤボンディング等によって各チャンネル毎に 1 対 1 で接続していたため、残留応力の発生に加えて、配線のための空間が必要になるために小型化が制約されるとともに、配線作業が複雑且つ繁雑であるため信頼性に欠けるばかりでなく、コストアップの要因になっていた。

又、前記特許 3248924 号公報の超音波探触子の製造方法では、溝に FPC を差し込み、信号電極と銅箔テープとを接着部を設けて接続し、その後、ダイシングを行って圧電素子切り込み及びチャンネル切り込みを形成し、その後、ダイシングによって分割された共通電極を一体にするために接着部を設けていたため、作業性が煩雑であるとともに、  
10 残留応力によって接着部が剥離して不具合が発生するおそれがあった。そして、切り込みを行った際に、接着部が剥離する等の不良が発生した場合、不良箇所の修正を行うことが難しく、歩留りが悪かった。

加えて、接着部を設けてフレキシブル基板を圧電素子に固定することによって、負荷重量によって各圧電素子の振動が抑制されるという不具合が発生する。

したがって、本発明は、圧電素子の振動が抑制されること及び残留応力による不具合の発生を防止し、作業性に優れ、歩留りの向上、コスト低減を図れ、信頼性の高い超音波振動子の提供及びその製造方法を提供することを目的にしている。

#### 【発明の開示】

本発明の超音波振動子は、少なくとも硬質な材料で形成された層を含む音響整合層と、音響整合層を構成する硬質な材料で形成された層の所定位置に音響整合層の一部が突出する位置関係に固定配置される両平面部に電極をそれぞれ設けた圧電体と、硬質な材料で形成された層の面に固定配置される少なくとも一面側に導電パターンを形成した基板と備え、この配置状態で圧電体及び基板を複数の圧電素子及び所定の導電パターンを配置した基板に分割して複数の圧電素子を配列させた超音波振動子であって、基板の導電パターンと、この導電パターンと電気的に接続される圧電体の電極の少なくとも一部とを同一方向に向け、この基板を圧電体に隣接配置し、分割される基板上の導電パターンと圧電体の電極とをそれぞれ導電部材を介して電気的に接続している。  
20 そして、本発明の超音波振動子の製造方法は、少なくとも硬質な材料で形成された音響整合層にグランド電極を設ける工程と、硬質な材料から音響整合層に電極を有する所定形状の圧電体を固定して第 1 積層体を形成する工程と、硬質な材料で形成された音響整合層面上に、所定間隔で形成した複数の導電パターンを有する所定形状の基板を、圧電体に隣接固定して第 2 積層体を形成する工程と、圧電体の電極と基板の導電パターンとを一体で電気的に接続する導電部材を設ける工程と、導電部材を設けて電気的に接続された圧電体及び基板に所定間隔及び所定深さ寸法の分割溝を形成する工程とを具備している。したがって、対応する圧電体の電極と基板の導電パターンとの電気的な接続を容易に行うことができるので、超音波振動子の小型化が可能になるとともに、作業性の向上及びコストの低減を図れる。また、圧電体の電極と基板の導電パターンとの電気的接続箇所に不良があった場合には容易に修正を行って歩留りの向上も図れる。  
30

#### 【図面の簡単な説明】

第 1 図は超音波振動子を示す斜視図、第 2 A 図は超音波振動子の構成を説明する長手方向断面図、第 2 B 図は第 2 A 図の矢印 B で示す部分の拡大図、第 2 C 図は第 2 A 図の矢印 B で示した部分の他の構成例を説明する図、第 2 D 図は第 2 A 図の矢印 B で示した部分の他の構成例を説明する図、第 2 E 図は第 2 A 図の矢印 C で示す部分の拡大図、第 3 図は第 2 A 図の A-A 線断面図、第 4 A 図は音響整合層を形成する部材を説明する図、第 4 B 図は音響接合層を説明する図、第 5 A 図は第 1 積層体を形成する部材を説明する図、第 5 B 図は第 1 積層体を説明する図、第 6 A 図は第 2 積層体を形成する部材を説明する図、第 6 B 図は第 2 積層体を説明する図、第 7 図は基板の導電パターンと圧電セラミックの一面側電極とを電気的に接続する工程を説明する図、第 8 A 図は分割溝を形成して圧電セラミックを圧電素子に分割している状態を示す図、第 8 B 図は切断工程により形成された分割溝  
40  
50

を有する第2積層体を切断方向から見た側視図、第9図は複数の圧電素子を設けた第2積層体を円筒状に変形させた図、第10A図は円筒状の振動子ユニットを形成する部材を説明する図、第10B図は第1音響整合層に形状形成部材を配置した状態を説明する図、第10C図は基板に形状形成部材を配置した状態を説明する図、第11A図はコンベックスアレイ型振動子ユニットを形成するための形状形成部材及び第2積層体を示す図、第11B図はリニアアレイ型振動子ユニットを形成するための形状形成部材及び第2積層体を示す図、第12A図は修正用マスク部材を使用して電気的接続不具合箇所の修正を行っている状態を説明する図、第12B図は電気的接続不具合箇所の修正を金属部材と導電性接着部を設けて行った状態を示す図、第13図は段差を有する圧電体と基板との電気的接続を説明する図、第14A図は他面側電極と導電パターンとの間の電気的な絶縁を図る一構成例を説明する図、第14B図は他面側電極と導電パターンとの間の電気的な絶縁を図る他の構成例を説明する図である。

10

#### 【発明を実施するための最良の形態】

本発明を、添付の図面にしたがってより詳細に説明する。

第1図に示すように本実施形態に係る超音波振動子1はラジアルアレイ型に構成したものである。超音波振動子1は、音響整合層2、パッキング材3、円筒状に形成した第1の振動子形状形成部材4a、第2の振動子形状形成部材（以下、形状形成部材と略記する）4b及び圧電素子5とを有する。音響整合層2は、硬質の材料で形成された第1音響整合層2aと、軟質の材料で形成された第2音響整合層2bとを積層して形成される。ここで「硬質」とは、予め形成した形状を保つことができる程度の硬さを意味する。一方、「軟質」とは変形などに関して柔軟性を有することを意味する。

20

第2A図及び第3図に示すようにパッキング材3、圧電素子5、第1音響整合層2a及び第2音響整合層2bは、超音波振動子1の円筒形状の中心から外周側に向けて順に配置される。第1の形状形成部材4aは音響整合層2を構成する第1音響整合層2aの内方向で、パッキング材3及び圧電素子5の一端側に隣接するように配置される。圧電素子5の他端側には基板6が配置される。

なお、基板6も超音波振動子1等の形状に倣い円筒状に形成される。基板6としては、例えば3次元基板、アルミナ基板、ガラスエポキシ基板、リジットフレキシブル基板、フレキシブル基板等が用いられる。

30

第2の形状形成部材4bは基板6の内周側で、パッキング材3の他端側に隣接するよう配置される。また、超音波振動子1の第1の形状形成部材4aが配置される側である一端側には音響整合層2が圧電素子5よりも長手軸方向に突出するように配置されている。

音響整合層2は、前述した通り第1音響整合層2a及び第2音響整合層2bで構成されるが、第1音響整合層2aの材料としては、例えばエポキシ系、シリコーン系、ポリイミド系等の樹脂部材に、金属、セラミックス、ガラス等の粉体や纖維を混合したもの、あるいはガラス、マシナブルセラミックス・シリコン等が用いられる。一方、第2音響整合層2bの材料としては、例えばシリコーン系、エポキシ系・P E E K・ポリイミド・ポリエーテルイミド・ポリサルフォン・ポリエーテルサルフォン・フッ素系樹脂等の樹脂部材やゴム等が用いられる。

第1図及び第3図に示すように第1音響整合層2a及び圧電素子5は所定数、例えば192個に分割されて配列される。

40

パッキング材3としては、例えばアルミナ粉末入りのエポキシ樹脂を硬化させたものが用いられる。なお、パッキング材3として、エポキシ系、シリコン系、ポリイミド系、ポリエーテルイミド、P E E K・ウレタン系・フッ素系等の樹脂部材やクロロブレンゴム・プロピレン系ゴム・ブタジエン系ゴム・ウレタン系ゴム・シリコーンゴム・フッ素系ゴム等のゴム材、又はこれら樹脂部材やゴム材にタンゲステン等の金属、アルミナ・ジルコニア・シリカ・酸化タンゲステン・圧電セラミックス粉・フェライト等のセラミックス、ガラス、樹脂等の粉体や纖維、中空の粒子などで形成された单一又は複数の物質・形状のフィラーを混合したものを用いても良い。

圧電素子5は、板状に形成されたチタン酸ジルコン酸鉛、チタン酸鉛・チタン酸バリウム

50

ム系・BNT-BST系等の圧電セラミック又は、LiNbO<sub>3</sub>・PZNT等の圧電性結晶・リラクサー強誘電体を切断して形成したものである。一面側電極5a及び他面側電極5bは板状の圧電セラミックの面上に金、銀、銅あるいはニッケル・クロム等の導電部材を焼付け又は蒸着・スパッタ・イオンプレーティング等の薄膜又はメッキ等により、単層・多層又は合金層として予め設けたものである。

ここで、第2A図における範囲Bの部分拡大図である第2B図ないし第2D図及び範囲Cの部分拡大図である第2E図に基づき、超音波振動子1における導電系につき説明する。

第2B図に示すように圧電素子5の内周側には一面側電極5aが設けられ、外周側には他面側電極5bが設けられている。音響整合層2を構成する第1音響整合層2aの内周側には略全周に亘ってグランド電極8が配置形成される。音響整合層2を構成する第1音響整合層2aの内周側かつ第1の形状形成部材4aの一端には、グランド電極8と接するよう導電部7が配置形成される。  
10

なお、グランド電極8の配置については、製造方法の記載と併せて後述する。

第1の形状形成部材4aは、第1音響整合層2aの内周面に対して導電部材、例えば導電接着剤(不図示)で接着固定される。これにより導電部7とグランド電極8とが電気的に導通された状態になる。なお、導電部材は導電接着剤に限定されるものではなく、半田や銀ロウ、金ロウ等の金属ロウ部材、或いは導体被膜等であってもよい。

このように、他面側電極5bと、導電部7と、グランド電極8とが電気的に接続される。

第2B図にあっては他面側電極5bと導電部7とが一体的に形成されるが、他面側電極5bと、導電部7と、グランド電極8とは、電気的に等位となるように接続されれば良い。例えば第2C図に示すように、グランド電極8が音響整合層2の一端側まで連続して設けられるようにしても良い。

また、第2D図に示すように、第1の形状形成部材4aの長手軸方向の長さである厚みより少量だけ長く形成して他面側電極5b及び導電部7に長手方向前後の一部分のみが接するように形成しても良い。この場合は、グランド電極8が外側に露出する構成とし、導電部4aとグランド電極6との間を、導電性樹脂・導電性塗料等の導体材料や、各種の導体薄膜・導体厚膜・メッキ等の導体皮膜で電気的な導通状態とする。また、これらの材料を組み合わせて用いても良い。

第2E図に示すように、圧電素子5と基板6とが隣接する部位の近傍にあっては、基板6の内周側に設けられた導電パターン6aと、一面側電極5aとを電気的に接続するように、導電部材9がバッキング材3の内周側に配置される。

第4A図から第10C図までを参照して、上述のように構成される超音波振動子1を製造する方法を説明する。

超音波振動子1を製造する方法は以下の工程で形成される。

#### (1) 音響整合層2を形成する工程

音響整合層2を形成するために、まず、第4A図に示すように所定寸法及び所定形状で、かつ所定の音響インピーダンス値に調整された第1音響整合層2a及び第2音響整合層2bを用意する。そして、第1音響整合層2aの一面側の所定位置には板状のグランド電極8を配置する。  
40

次に、第4B図に示すように第1音響整合層2aと第2音響整合層2bとを一体的に積層して音響整合層2を形成する。このとき、第2音響整合層2bを、グランド電極6が設けられていない第1音響整合層2aの他面側に配置する。音響整合層2は、各々を所定厚さとした後に一体化しても、一体化させた後に所定厚さにしても、接合せずに一方に他方を塗布、注型、成膜等により直接形成しても良く、これらの組合せにより形成しても良い。

なお、グランド電極8は、第1音響整合層2aの所定位置に形成した所定幅寸法及び深さ寸法の溝11に、所定幅寸法及び厚み寸法に形成した板状の導電部材12を接着して配置しても良い。また、グランド電極8は、溝11に所定幅寸法で前記深さ寸法より厚めに

10

20

30

40

50

形成した板状の導電部材を接着して配置しても良い。また、グランド電極8は、図示しない導電樹脂等を突出するように塗布或いは充填した後、この導電部材の突出部分を第1音響整合層2aの面と面一致状態になるように加工して形成しても良い。また、グランド電極8は、所定厚み寸法より厚めに形成した第1音響整合層2aの溝11内に導電部材を接合ないし塗布或いは充填した後、全体を所定厚み寸法になるように加工して形成しても良い。また、グランド電極8は、各種の導体膜で形成しても良い。

そして、グランド電極8には、例えば導電性樹脂・導電性塗料・金属等の導体材料や、各種の導体薄膜・導体厚膜・メッキ等の導体皮膜が使用される。

#### (2) 第1積層体を形成する工程

前記第1の工程により形成された音響整合層2と、一面側電極5a及び他面側電極5bを圧電素子の両面に設けた圧電セラミック13とから、第1積層体21を形成する。圧電セラミック13は、音響整合層2の長さ寸法より所定寸法だけ短く形成され、幅寸法は略同一寸法で形成され、厚み寸法は所定寸法に形成される。10

具体的には、まず、第5A図に示すように音響整合層2及び圧電セラミック13を準備する。

次に、第5B図に示すように音響整合層2のグランド電極8が形成された面に、圧電セラミック13の他面側電極5bを、グランド電極8と少なくとも一部が接触するよう、略矩形状の音響整合層2の一辺から所定量である例えば距離aだけオフセットした位置に接着固定する。

こうして、他面側電極5bと圧電セラミック13のグランド電極6とが電気的導通状態とされた一体的な第1積層体21が形成される。このとき、グランド電極6が配置されている音響整合層2の一端面側が圧電セラミック13の一端面側から距離aだけ突出した状態になる。20

#### (3) 第2積層体を形成する工程

前述した工程で形成された第1積層体21及び導電パターン6aから第2積層体22を形成する。

まず、第6A図に示すように第2工程で形成した第1積層体21と、例えば一面側に複数の導電パターン6a, …, 6aが所定の間隔で規則的に配列された基板6とを準備する。この基板の厚み寸法は、圧電セラミック13の厚み寸法と略同寸法である。

次に、第6B図に示すように導電パターン6a, …, 6aを上向きにした状態で、基板6を圧電セラミック13に隣接するように配設し、第1音響整合層2aに対して接着固定する。30

こうして、第1音響整合層2aの面上に圧電セラミック13と基板6とが隣接して配置された第2積層体22が形成される。なお、基板6の幅寸法及び長さ寸法は所定寸法に設定される。

(4) 基板の導電パターン6a, …, 6aと圧電セラミック13の一面側電極5aとを電気的に接続する工程

第7図に示すように第2積層体22の導電パターン6aが形成されている基板7及び一面側電極5aが設けられている圧電セラミック13の表面の所定位置に図示しないマスク部材を配置し、膜部材である導電性塗料又は導電性接着剤等を塗布したり、金、銀、クロム、二酸化インジウム等の金属や導体を蒸着、スパッタ、イオンプレーティング、CVD等の方法で付着させて、導電膜部14を設ける。40

こうして導電膜部14を形成することにより、導電パターン6a, …, 6aと一面側電極5aとが電気的に接続される。

#### (5) 圧電セラミック13を複数の圧電素子5, …, 5に分割する工程

第8A図に示すように圧電セラミック13及び基板6の表面側から音響整合層2を構成する第1音響整合層2aを通過させて第2音響整合層2bの一部に到達する所定深さ寸法で所定幅寸法又は所定形状の分割溝15を長手方向に対して直交する方向に所定ピッチで形成していく。尚、この分割溝15は、図示しないダイシングソー又はレーザ装置等の切断手段を用いて形成する。このとき、前記切断手段を2つの導電パターン6a, 6aを分50

割する中央線上に配置させる。

この工程にあっては、複数の導電パターン 6 a, …, 6 a を設けた基板 6 が、少なくとも 1 つの導電パターン 6 a が配置された複数の基板 6, …, 6 に分割されるとともに、圧電セラミック 1 3 も複数個に分割される。このとき、導電膜部 1 4 は複数の導電部材 9 に分割される。このことによって、1 つの音響整合層 2 上に、個々の導電パターン 6 a を導電部材 9 で電気的に接続した圧電素子 5, …, 5 が複数個配列されるようになる。

第 8 B 図に示すように第 2 積層体 2 2 に分割溝 1 5 を所定ピッチで所定個数形成する。このことによって、圧電セラミック 1 3、基板 6、導電膜部 1 4 及び第 1 音響整合層 2 a が所定個数に分割されて、圧電セラミック 1 3 及び基板 6 から形成されていた第 2 積層体 2 2 が、複数の圧電素子 5, …, 5 及び複数の基板 6, …, 6 を配置した積層体群で形成された第 2 積層体 2 2 a になる。言い換えれば、音響整合層 2 を構成する柔軟性を有する第 2 音響整合層 2 b に、複数の圧電素子 5, …, 5 を配列した状態になると言える。  
10

次いで、第 2 音響整合層 2 b が最外周側に配置されるように第 2 積層体 2 2 a を曲げ変形させて、第 9 図に示すように第 2 積層体 2 2 a を円筒形状に形成する。

なお、分割溝 1 5 を形成した後、超音波振動子 1 を形成するに当たって不要になる、例えば第 8 A 図の斜線に示す音響整合層 2 を除去する。また同様に、第 2 積層体 2 2 を構成する各部材について、例えば長さなどについては所定形状よりも大きいものを用い、最終的に不要部分を除去しても良い。さらに必要に応じ、それぞれの圧電素子 5, …, 5 の一面側電極 5 a と、基板 6, …, 6 の導電パターン 6 a とが導電部材 9 によって電気的に接続されているかの導通検査を行う。  
20

#### (6) 円筒状振動子ユニット（以下、円筒状ユニットと略記する） 2 3 を形成する工程

前述の工程で形成された第 2 積層体 2 2 a と、第 1 及び第 2 の形状形成部材 4 a、4 b とから円筒状ユニット 2 3 を形成する。

具体的には、第 10 A 図に示すように第 2 積層体 2 2 a を円筒状に形作った後、第 10 B 図に示すように第 1 の形状形成部材 4 a を音響整合層 2 の第 1 音響整合層 2 a に導電接着剤で一体的に接着固定する。また、第 10 C 図に示すように第 2 の形状形成部材 4 b を圧電素子 5, …, 5 に隣接する基板 6, …, 6 の内周面側に非導電性の接着剤によって一体的に接着固定する。

こうして、硬質の材料で形成された第 1 音響整合層 2 a と、第 1 の形状形成部材 4 a 及び基板 6 と、第 2 の形状形成部材 4 b とを接着固定することにより、第 2 積層体 2 2 a から所定の曲率の円筒状ユニット 2 3 が形成される。このとき、分割された圧電素子 5, …, 5 にそれぞれ設けられている他面側電極 5 b と導通状態となっているグランド電極 8 と、第 1 の形状形成部材 4 a の導電部 7 とは一体的に導通状態となる。  
30

導電部 7 には、図示しない超音波観測装置から延出するグランド線が接続され、容量が十分に大きいグランドが確保される。なお、第 1 の形状形成部材 4 a を第 1 音響整合層 2 a に非導電性接着剤により接着し、その後に導体薄膜、導電性樹脂、導体厚膜等によって電気的に接続するようにしても良い。

このように、圧電セラミック 1 3 に設けた所定の電極及び形状形成部材の導電部と電気的に導通状態になるグランド電極 8 を音響整合層 2 に予め設け、このグランド電極 8 と圧電セラミック 1 3 に設けた所定の電極及び形状形成部材の導電部 7 とを組立てる工程時に電気的に接続することによって、各圧電素子 5, …, 5 にそれぞれ設けられている他面側電極 5 b を、導電部 7 によって一体になったグランド電極 8 に接続して大容量のグランドを確保することができる。  
40

なお、本実施形態においては第 1 形状形成部材 4 a 及び第 2 形状形成部材 4 b を用いてラジアルアレイ型の超音波振動子 1 を形成する工程を説明したが、本工程で示した形状形成部材 4 a、4 b を使用する代わりに、第 11 A 図に示すように例えば部分円筒形状等に形成した第 3 の形状形成部材 4 c、第 4 の形状形成部材 4 d を上述と同様に所定形状で所定数に分割された圧電素子 5, …, 5 を有する第 2 積層体 2 2 b の第 1 音響整合層 2 a に固定することによってコンベックスアレイ型振動子ユニットが形成するようにしてもよい。

なお、第11B図に示すように、端部が平坦である平板状の形状形成部材4eを準備するとともに、上述の工程と同様に第2積層体22cの第1音響整合層2aに該平坦部が接するように形状形成部材4eを固定すると、リニアアレイ型振動子ユニットが形成される。さらに、形状形成部材の端部形状は円弧や直線に限定されるものではなく、これらの組合せや変形も可能であり、これにより複数個配列されるアレイを自由に配置することができる。よって、超音波の走査方向を自在に設定することができる。

このとき、グランド電極6と形状形成部材4aの導電部7とが導通状態になる。この導電部7に図示しない超音波観測装置から延出するグランド線を接続することによって十分な容量のグランドが確保される。形状形成部材4aは、固定を非導電性接着剤により行い、その後に導体薄膜、導電性樹脂、導体厚膜等によって電気的に接続しても、何ら問題はない。さらに、形状形成部材4aの端部形状は円弧や直線に限定されるものではなく、これらの組合せや変形も可能であり、これにより複数個配列されるアレイを自由に配置することができ、よって超音波の走査方向を自在に設定することができる。  
10

また、前記導通検査で不合格であった第2積層体22aのうち、一面側電極5aと導電パターン6aとの電気的な接続に不具合がある場合には、必要に応じ不具合箇所の圧電素子5の一面側電極5aと基板7の導電パターン6aとを電気的に接続する修正作業を行う。  
。

その際、第12A図に示すように第2積層体22aを修正治具(不図示)に配置し、不良箇所の圧電素子5及び基板6の導電パターン6aに対応する位置に修正用マスク部材24の開口24aを配置した状態にする。その後、例えば導電性塗料又は導電性接着剤等を塗布して、圧電素子5の一面側電極5aと基板6の導電パターン6aとを電気的に接続する修正用導体膜部を設ける修理を行う。  
20

そして、不具合箇所の修正を完了後に再度導通検査を行って、この検査に合格であった場合には修正した第2積層体22aを円筒状ユニット23を形成する工程に廻す。

また、第12A図に示したように導電性塗料を塗布して、圧電素子5の一面側電極5aと基板6の導電パターン6aとを電気的に接続する代わりに、第12B図に示すように不具合のある一面側電極5aと導電パターン6aとの上に金属部材25を配置し、この金属部材25を、一面側電極5a及び導電パターン6aに例えば導電性接着部26を設けたり超音波接合するなどして固定する。

こうして、不具合箇所の圧電素子5の一面側電極5aと基板6の導電パターン6aとを電気的に接続する修正作業を行える。  
30

なお、これらの方法は、不具合部の修正のみならず、圧電素子5及び基板6の導電パターン6aとの間の電気的接続行為そのものにも使用できることは言うまでもない。

#### (7) バッキング材を形成する工程

バッキング材3は、圧電素子5の一面電極5a側に、フェライト入りゴム材・アルミナ粉入りエポキシ等を材料として用い、接着・注型等の方式により形成することにより前記第1図ないし第3図に示したような構成のラジアルアレイ型の超音波振動子を形成する。

なお、本実施形態においては圧電セラミック13及び基板7の厚さ寸法を略同一としているが、圧電セラミック13及び基板6の厚さ寸法は略同一に限定されるものではない。例えば第13図に示すように圧電セラミック13と基板6の厚さ寸法が異なっている場合でも、圧電素子5の一面側電極5aと基板6の導電パターン6aとの電気的接続を前記薄膜や導電性塗料又は導電性接着剤等で形成した導電膜部14などによる電気的接続部を設けた後、一点鎖線に沿って分割することによって、音響整合層2上に導電パターン6aを導電部材9で電気的に接続した圧電素子5, …, 5が配列される。  
40

このように、圧電体に基板を隣接させて配置するとともに、基板に設けられている導電パターンと、この導電パターンに電気的に接続される圧電体の電極とを同一の向きに配置することによって、対応する圧電体の電極と基板の導電パターンとの電気的な接続を容易に行うことができる。

また、圧電体と基板との厚み寸法に関わらず、対応する圧電体の電極と基板の導電パターンとの電気的な接続を容易に行うことができる。  
50

これらのことによって、超音波振動子の小型化が可能になるとともに、作業性の向上及びコストの低減を図れる。また、圧電体の電極と基板の導電パターンとの電気的接続箇所に不良があった場合には容易に修正を行って歩留りの向上も図れる。

尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能である。例えば、本実施形態では基板6を圧電素子5に併設配置し導電部材により両者を電気的に接続したが、これに限定されるものではなく、例えばパッキング材の内部又は側面に基板を位置させたり、フレームと基板とを合一すること、基板と圧電素子とを金属細線等で接続しても良い。

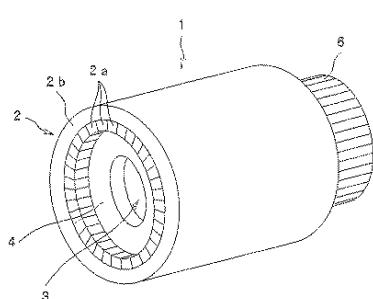
また、例えば、第14A図及び第14B図に示すように、導電パターン6bを基板7の一端面から一主面に連続的に設けることで、この導電パターン6bのアレイ外部への取り出し端子を、外周に配置するように設計することが可能になる。このことによって、超音波振動子を製品に搭載する際に、設計の自由度が拡大するという効果を得られる。この際には、図に示すように、基板6の形状或いは圧電素子5の電極5bの形状等を調整して、導電パターン6bと電極5bとの間の電気的絶縁が確保される。  
10

#### 【産業上の利用可能性】

以上のように、本発明にかかる超音波振動子は、コスト低減が図られ、かつ信頼性が高いので、超音波断層画像を得るための超音波観察用等として有用である。

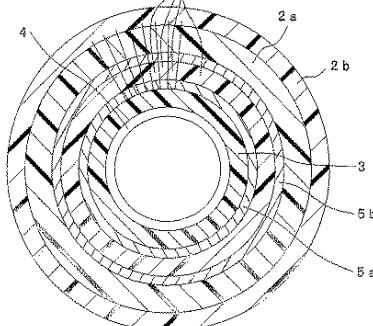
【図1】

第1図

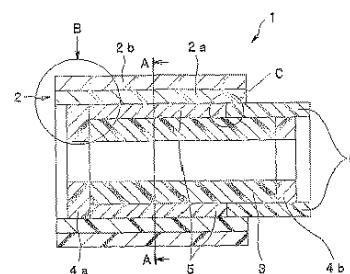


【図3】

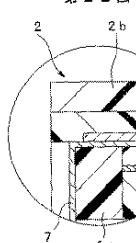
第3図



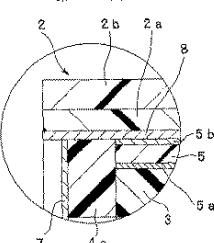
第2A図



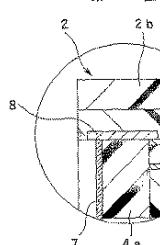
第2B図



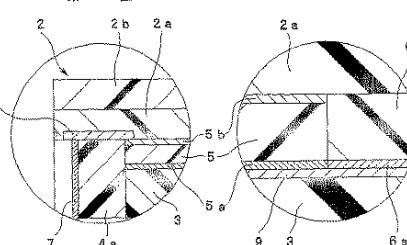
第2C図



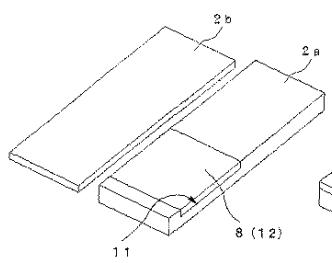
第2D図



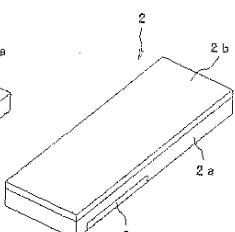
第2E図



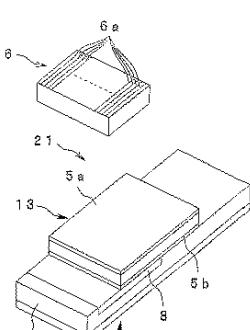
第4A図



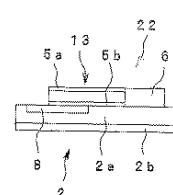
第4B図



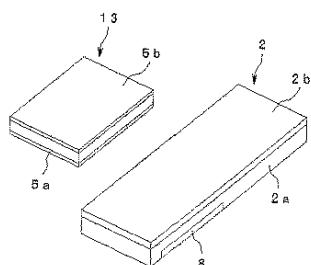
第6A図



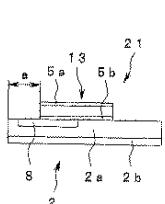
第6B図



第5A図

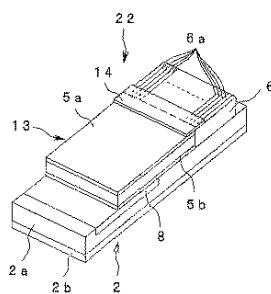


第5B図

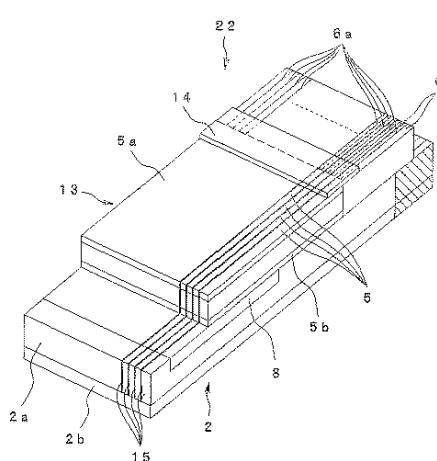


【図7】

第7図

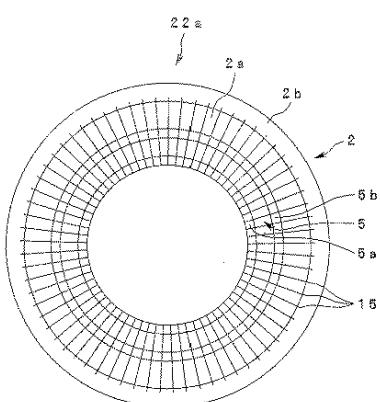


第8A図

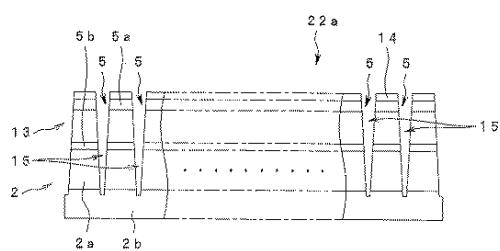


【図9】

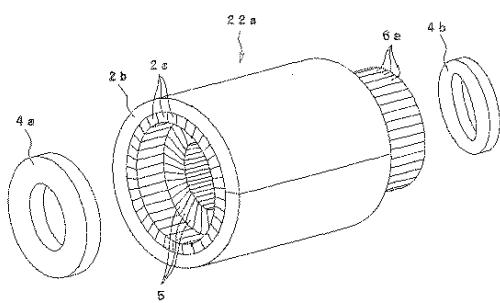
第9図



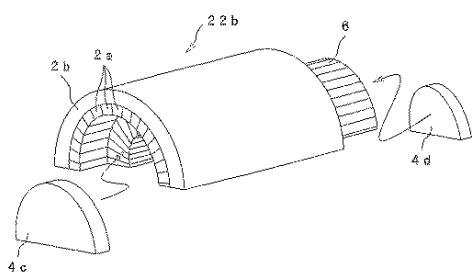
第8B図



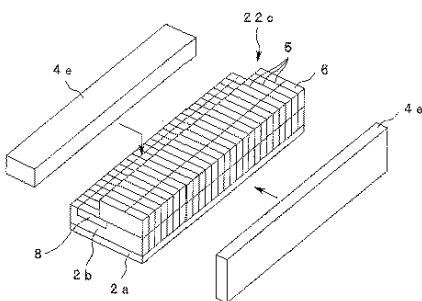
第 10 A 図



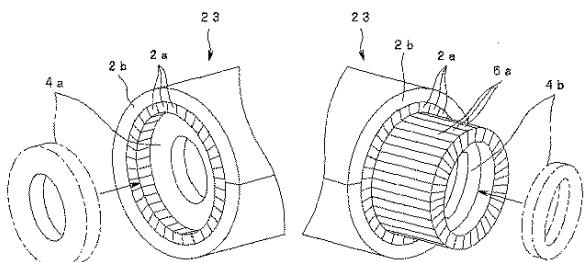
第 11 A 図



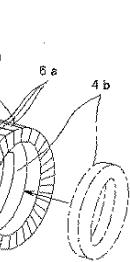
第 11 B 図



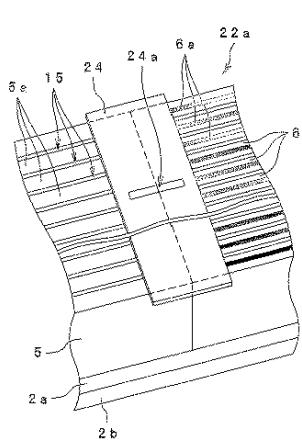
第 10 B 図



第 10 C 図

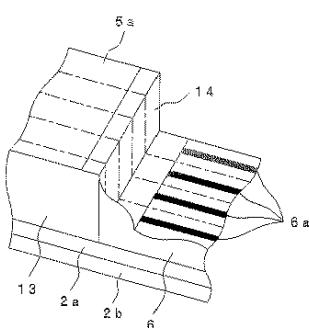


第 12 A 図

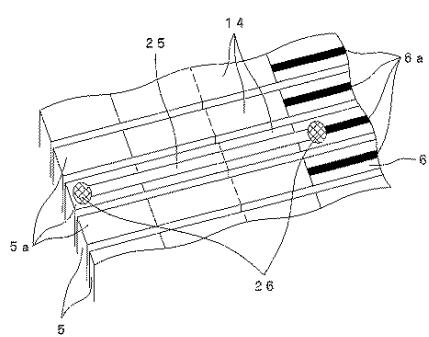


【図 13】

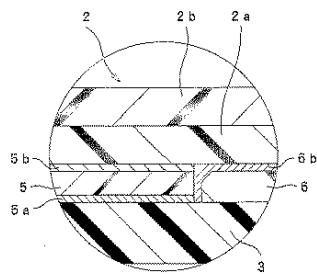
第 13 図



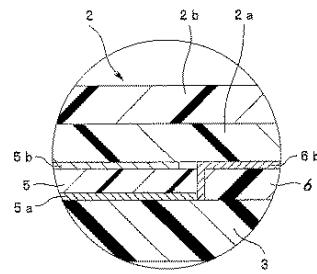
第 12 B 図



第14A図



第14B図

**【手続補正書】****【提出日】**平成18年2月20日(2006.2.20)**【手続補正1】****【補正対象書類名】**特許請求の範囲**【補正対象項目名】**全文**【補正方法】**変更**【補正の内容】****【特許請求の範囲】****【請求項1】**

少なくとも硬質な材料で形成された層を含む音響整合層と、前記音響整合層を構成する硬質な材料で形成された層の所定位置に前記音響整合層の一部が突出する位置関係に固定配置される両平面部に電極をそれぞれ設けた圧電体と、前記硬質な材料で形成された層の面に固定配置される少なくとも一面側に導電パターンを形成した基板とを備え、この配置状態で前記圧電体及び基板を複数の圧電素子及び所定の導電パターンを配置した基板に分割して複数の圧電素子を配列させた超音波振動子において、

前記基板の導電パターンと、この導電パターンと電気的に接続される圧電体の電極の少なくとも一部とを同一方向に向け、この基板を前記圧電体に隣接配置し、分割される前記基板上の導電パターンと前記圧電体の電極とをそれぞれ導電部材を介して電気的に接続することを特徴とする超音波振動子。

**【請求項2】**

前記導電部材は、金属ロウ、超音波接合、接着剤で接続固定される導電性部材、導電性接着剤、導電性塗料、焼付け、スパッタ、イオンプレーティング、CVD又は蒸着の中のいずれか及びこれらの組合せによって設けられる導電性の膜部材であることを特徴とする請求項1に記載の超音波振動子。

**【請求項3】**

前記膜部材は、厚膜であることを特徴とする請求項1または請求項2のいずれか一つに記載の超音波振動子。

【請求項4】

前記膜部材は、薄膜であることを特徴とする請求項1または請求項2のいずれか一つに記載の超音波振動子。

【請求項5】

少なくとも硬質な材料で形成された音響整合層に設けられるグランド電極と、

前記硬質な材料から音響整合層に電極を有する所定形状の圧電体を固定して形成される第1積層体と、

前記硬質な材料で形成された音響整合層面に、所定間隔で形成した複数の導電パターンを有する所定形状の基板を前記圧電体に隣接固定して形成される第2積層体と、

前記圧電体の電極と前記基板の導電パターンとを一体で電気的に接続される導電部材と、

前記導電部材を設けて電気的に接続された圧電体及び基板に形成される所定間隔及び所定深さ寸法の分割溝と、

を具備することを特徴とする超音波振動子。

【請求項6】

前記圧電体の厚み寸法及び前記基板の厚み寸法を略同一に設定したことを特徴とする請求項5に記載の超音波振動子。

【請求項7】

前記導電部材は膜部材であることを特徴とする請求項5または請求項6のいずれか一つに記載の超音波振動子。

【請求項8】

前記膜部材は厚膜であることを特徴とする請求項5ないし請求項7のいずれか一つに記載の超音波振動子。

【請求項9】

前記膜部材は薄膜であることを特徴とする請求項5ないし請求項7のいずれか一つに記載の超音波振動子。

【請求項10】

少なくとも硬質な材料で形成された音響整合層にグランド電極を設ける工程と、

前記硬質な材料から音響整合層に電極を有する所定形状の圧電体を固定して第1積層体を形成する工程と、

前記硬質な材料で形成された音響整合層面に、所定間隔で形成した複数の導電パターンを有する所定形状の基板を前記圧電体に隣接固定して第2積層体を形成する工程と、

前記圧電体の電極と前記基板の導電パターンとを一体で電気的に接続する導電部材を設ける工程と、

前記導電部材を設けて電気的に接続された圧電体及び基板に所定間隔及び所定深さ寸法の分割溝を形成する工程と、

を具備することを特徴とする超音波振動子の製造方法。

【請求項11】

前記圧電体の厚み寸法及び前記基板の厚み寸法を略同一に設定したことを特徴とする請求項10に記載の超音波振動子の製造方法。

【請求項12】

前記導電部材は膜部材であることを特徴とする請求項10または請求項11のいずれか一つに記載の超音波振動子の製造方法。

【請求項13】

前記膜部材は厚膜であることを特徴とする請求項10ないし請求項12のいずれか一つに記載の超音波振動子の製造方法。

【請求項14】

前記膜部材は薄膜であることを特徴とする請求項10ないし請求項12のいずれか一つ

に記載の超音波振動子の製造方法。

## 【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2004/004777
<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> Int.Cl <sup>7</sup> H04R17/00		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl <sup>7</sup> H04R17/00, A61B8/00, G01N29/24		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT.</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2002-27594 A (Hitachi, Ltd., Hitachi Medical Corp.), 25 January, 2002 (25.01.02), Par. Nos. [0006] to [0009]; Fig. 6 (Family: none)	1-14
A	JP 3344422 B2 (Intravascular Research Ltd.), 11 November, 2002 (11.11.02), Full text; all drawings & GB 2258364 A & EP 596974 A & US 5456259 A1 & WO 93/2809 A1	1-14
Y	JP 2002-84597 A (Parallel Design, Inc.), 22 March, 2002 (22.03.02), Full text; Figs. 5 to 7	1-4
A	& WO 94/16826 A1 & US 5423220 A1 & EP 681513 A & AU 6828294 A	5-14
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C.		<input type="checkbox"/> See patent family annex.
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 29 June, 2004 (29.06.04)		Date of mailing of the international search report 20 July, 2004 (20.07.04)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2004/004777

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 10-192281 A (Endosonics Corp.), 28 July, 1998 (28.07.98), Full text; all drawings & CA 2226194 A & EP 853919 A2 & US 5857974 A1	1-14

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2004/004777									
A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））											
Int. Cl' H04R17/00											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））											
Int. Cl' H04R17/00, A61B8/00, G01N29/24											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの											
<table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2004年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2004年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2004年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2004年	日本国登録実用新案公報	1994-2004年	日本国実用新案登録公報	1996-2004年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2004年										
日本国登録実用新案公報	1994-2004年										
日本国実用新案登録公報	1996-2004年										
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号									
Y	JP 2002-27594 A(株式会社日立製作所, 株式会社日立メディコ) 2002.01.25, 【0006】-【0009】段落, 第6図; (ファミリーなし)	1-14									
A	JP 3344422 B2(イントラヴァスキュラー・リサーチ・リミティッド), 2002.11.11, 全文, 全図 & GB 2258364 A & EP 596974 A & US 5456259 A1 & WO 93/2809 A1	1-14									
Y	JP 2002-84597 A(パラレル デザイン, インコーポレイテッド)	1-4									
A	2002.03.22, 全文, 第5-7図 & WO 94/16826 A1 & US 5423220 A1 & EP 681513 A & AU 6828294 A	5-14									
A	JP 10-192281 A(エンドソニックス・コーポレーション)1998.07.28 全文, 全図 & CA 2226194 A & EP 853919 A2 & US 5857974 A1	1-14									
<input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。		<input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。									
<p>* 引用文献のカテゴリー</p> <p>「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの</p> <p>「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの</p> <p>「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）</p> <p>「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献</p> <p>「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願</p> <p>日の後に公表された文献</p> <p>「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの</p> <p>「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの</p> <p>「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの</p> <p>「&amp;」同一パテントファミリー文献</p>											
国際調査を完了した日 29.06.2004		国際調査報告の発送日 20.7.2004									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/JP） 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官（権限のある職員） 松沢 福三郎	5C 7254								
電話番号 03-3581-1101 内線 3540											

---

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EPC  
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI,  
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE,  
DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, M  
D, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US  
, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(注) この公表は、国際事務局（W I P O）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に  
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法  
第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	超声波振荡器及其制造方法		
公开(公告)号	<a href="#">JPWO2004091255A1</a>	公开(公告)日	2006-07-06
申请号	JP2005505243	申请日	2004-04-01
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	沢田之彦		
发明人	沢田 之彦		
IPC分类号	A61B8/00 G01N29/24 H04R17/00 H04R31/00 B06B1/06		
CPC分类号	B06B1/0633 B06B1/067		
FI分类号	A61B8/00 G01N29/24.502 H04R17/00.330.J H04R17/00.332.Y H04R31/00.330		
F-TERM分类号	2G047/AA12 2G047/AC13 2G047/CA01 2G047/DB02 2G047/EA11 2G047/EA16 2G047/GB02 2G047 /GB18 2G047/GB21 2G047/GB29 2G047/GB32 2G047/GB35 4C601/BB06 4C601/BB24 4C601/EE10 4C601/EE14 4C601/GB05 4C601/GB41 4C601/GB44 5D019/BB02 5D019/BB20 5D019/FF04 5D019 /GG01 5D019/HH03		
代理人(译)	伊藤 进		
优先权	2003098216 2003-04-01 JP 2003098217 2003-04-01 JP		
其他公开文献	JP4323487B2		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

#### 摘要(译)

超声换能器包括声匹配层，该声匹配层至少包括由硬质材料形成的层和声匹配层的一部分在由形成声匹配层的硬质材料形成的层的预定位置处突出的部分压电体在两个固定布置的平坦表面上设置有电极，并且基板固定地设置在由硬质材料形成的层的表面上并且具有形成在其至少一侧上的导电图案，在一个分割的压电和衬底的衬底上，其中，多个压电元件和预定的导电图案超声换能器被布置在多个压电元件，和基板的导电图案，将所述导电图案连接到所述面和至少在相同方向上的压电体的电极的一部分，该基板设置成邻近所述压电元件，通过相应的导电构件和所述导电图案和所述压电基板的电极进行划分电特并不断。

